



功能性表面处理药剂（防止金属变色）：

一、适用于连接器接点的后处理药剂：

产品名称	用途	特点
CT-3	Au (/Ni) 镀层的封孔处理/Ag镀层的变色防止 (FFC等)	高耐腐蚀性 (耐盐水喷雾) /高拨水性/耐硫化性
CT-3S	Au (/Ni) 镀层的封孔处理 (微型连接器)	高耐腐蚀性 (耐盐水喷雾) /高拨水性/短时间浸渍 (5s)
CT-5A	耐热性Ag变色防止	高耐热性/粘合性无影响
CT-3u	防止Ag镀层变色/电解式	通过CT-3以上的耐硫化性 阴极电解处理, 进一步提高耐硫化性
CT-88S	Au (/Ni), Sn双色镀层的防锈剂	通过1个工艺提高Au (/Ni) 镀层面和Sn镀层面双方的耐腐蚀性, 处理后直接干燥
TG-3	防Sn和Sn合金氧化	强酸性/防止热处理导致的氧化 (变色)
TG-4	防Sn和Sn合金氧化	强酸性/防止在高温高湿环境中存放时或运输时氧化 (变色)
TG-6	防Sn和Sn合金氧化	中性/用于不耐酸的零部件
TG-6P	防Sn和Sn合金氧化/无磷	中性/用于不耐酸的零部件 符合磷排放标准的Sn后处理剂

二、适用于功率半导体器件的后处理药剂：

产品名称	用途	特点
CT-3S	防止Ni镀层的氧化/增强耐腐蚀性 (散热板等)	抑制Ni面的焊料润湿性下降/高拨水性
CT-5A	防止Ni镀层的氧化	Ni面与树脂的粘附性增强
Wotto3-V	Ni的耐腐蚀性增强	Ni镀层的耐腐蚀性增强/高拨水性



三、适用于连接器接点的后处理药剂:

产品名称	用途	特点
CT-3	Au (/Ni) 镀层的封孔处理/Ag镀层的变色防止 (FFC等)	高耐腐蚀性 (耐盐水喷雾) /高拨水性/耐硫化性
CT-5A	耐热性Ag变色防止	高耐热性/粘合性无影响
CT-3u	防止Ag镀层变色/电解式	通过CT-3以上的耐硫化性 阴极电解处理, 进一步提高耐硫化性
TG-4R	Ag上RBO※防止剂 (※ Resin Bleed Out)	高RBO性/耐硫化性/粘合性无影响
LA-1	Ag/硅树脂间的粘附性增强	含有本公司独有的硅烷偶联剂, 与未处理相比粘附强度达2~3倍, 对Ag面的光泽度, 反射率, 粘合性无影响
RCA-1	Ag重结晶抑制剂	抑制加热导致银镀层皮膜的光泽度变化

四、其他后处理药剂:

产品名称	用途	特点
NT-1	防止功率半导体模块用铜材的加热变色 (IGBT模块用散热板等)	硅烷偶联剂/形成厚有机膜/防止高温加热变色 耐盐水喷雾性良好/与树脂的粘附性增强
KI-200	铜防变色剂 (热沉/VCM蚀刻弹簧等)	高耐湿性/铜及铜合金用
Aurum Stripper-710H	金镀层剥离剂	加氰型/剥离速度快/对基底的影响小

五、咪唑硅烷 (硅烷偶联剂):

产品名称	用途	特点
IM-1000	添加至树脂产品/通过表面处理提高粘接性能/达到促进树脂硬化的效果	在有机溶剂中可溶
IS-1000	添加至树脂产品/通过表面处理提高粘接性能/达到促进树脂硬化的效果	水溶性